

| 单位         |                      | 职 掌 概 要   |
|------------|----------------------|---|
| 稽核室        |                      | 协助董事会及经理人检查、评估内部控制制度、管理规章及作业流程管理，并提供分析及建议，以确保内部控制制度得以持续有效运作。  |
| 总经理室       |                      | 1. 公司未来短、中、长程发展之营运目标及计划之拟定及修订。<br>2. 监督各部室执行营运计划以达成公司营运目标、追求永续经营。<br>3. 对外公共关系之建立。  |
| 新竹设计中心     | 设计一处<br>设计三处         | 1. 公司短期、中、长期研发计划之规画及执行。<br>2. 新产品之研发与认证、专利技术之建立与申请。   |
|            | 产品布局一部               | 1. 基本电路组件(含特殊组件)、新旧产品之布局设计作业。<br>2. 产品除错/验证工程之协寻作业。   |
|            | 设计服务部                | 1. 集成电路代工厂提供之开发工具的管理。<br>2. 集成电路布局验证程序的问题排除。<br>3. 集成电路之自动布局及其验证。   |
| 台北设计中心     | 设计二处<br>设计四处         | 1. 公司短期、中、长期研发计划之规画及执行。<br>2. 新产品之研发与认证、专利技术之建立与申请。   |
|            | 产品布局二部               | 1. 基本电路组件(含特殊组件)、新旧产品之布局设计作业。<br>2. 产品除错/验证工程之协寻作业。   |
| 业务中心       | 产品企划部                | 1. 新产品营销策略之建立及执行。<br>2. 新产品开发进度之追踪与各部门工作之协调。<br>3. 新产品基础客户之开发与市场推展。<br>4. 提供产品线总体市场分析报告-TAM analysis。   |
|            | 业务一部<br>业务二部<br>业务三部 | 1. 年度销售目标及营业计划之拟定及执行，以达成年度营销目标。<br>2. 新市场、新客户之开发，以提升市场占有率。<br>3. 服务客户各项需求及客户诉怨受理与处理。  |
|            | 深圳代表处<br>上海代表处       | 1. 大陆市场及新客户之开发，以提升市场占有率。<br>2. 服务客户各项需求及客户诉怨受理与处理。  |
|            | 财务部                  | 1. 统筹公司的财务、会计、税务及经营分析等事宜。<br>2. 年度预算之编制、汇总及控制。<br>3. 各项理财活动之调度及运用。<br>4. 公司股东会、董事会及服务作业相关事宜。  |
| 管理中心       | 人事部                  | 1. 行政制度之拟定与实施、各项人事管理作业之规画及执行。<br>2. 各项教育训练之规画及执行。<br>3. 各项薪酬与奖惩制度之规画及执行。  |
|            | 生产企划部                | 1. 拟定年度生产计划及物料需求计划及管理。<br>2. 产能规画及管理。<br>3. 各项存货之仓储、管理与收发。<br>4. 各项成品销货运输作业之管理。<br>5. 各项采购策略、采购计划之规画及执行。  |
| 生产管理<br>中心 | 质量保证部                | 1. 公司标准化、质量系统/活动之维护及推动。<br>2. 文件及记录管制作业。<br>3. 禁限用物质调查及管理。<br>4. 外包厂商之评鉴、质量督导、异常处理。<br>5. 半成品及成品之抽检。<br>6. 实验室仪器校正管理。<br>7. 协助产品开发之相关可靠度实验、失效分析、专利申请。 |

| 单位     |                | 职 掌 概 要   |
|--------|----------------|---|
|        | 产品测试部          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开发/维护产品相关之测试程序、增加程序功能，使其能提供量产/工程数据。</li> <li>2. 提升测试程序之侦错能力，以增进出货质量；提升程序效率，节省测试时间。</li> <li>3. 量产产品生产状况之掌握与维护。</li> <li>4. 提升工程能力，解决产品相关之技术问题。</li> </ol>   |
| 系统应用中心 | 韧体设计部<br>韧体应用部 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 协助 IC 设计及企划部门订定新产品数字电路规格。</li> <li>2. 验证新开发产品(FPGA/IC)能符合实际应用规格。</li> <li>3. 新产品使用及开发平台发展。</li> <li>4. 标准化产品软件模块开发。</li> <li>5. 配合业务部门进行新产品的推展。</li> <li>6. 客户使用产品问题处理及分析。</li> <li>7. 产品量产系统开发。</li> </ol> |
|        | 硬件应用部          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 协助设计 IC 应用之 PCB 布局及基本电路组件(含特殊组件)之布局设计作业。</li> <li>2. 设计 Module 之应用及验证，确保新开发产品能符合实际应用规格。</li> <li>3. 验证 IC 应用之温度测试及特性分析、产品除错/验证工程之作业。</li> <li>4. 客户退货及故障产品之应用分析。</li> <li>5. 产品应用状况之掌握与维护。</li> </ol>       |
|        | 工程支持部          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 协助工程师焊接 Module。</li> <li>2. 协助工程样品制作。</li> <li>3. 提供业务需求的 Module。</li> </ol>  |
|        | 芯片验证部          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设计 IC 验证之 PCB 布局。</li> <li>2. 设计 Module 之应用及验证。</li> <li>3. 验证 IC 应用之温度测试及特性分析。</li> <li>4. 撰写特定应用参考设计规格书。</li> <li>5. 确保新开发产品能符合实际应用规格。</li> </ol>   |
|        | 软件应用部          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供客户标准化软件链接库。</li> <li>2. 撰写标准化软件链接库使用说明书。</li> <li>3. 协助客户顺利整合标准化软件链接库，让客户能自行客制化应用软件。</li> </ol>   |
|        | 信息服务部          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各项计算机化信息系统软件、硬件之规画及执行。</li> <li>2. 各项电信系统及委外工程之协调与管理。</li> <li>3. 协助各部门之工作信息科技化。</li> </ol>   |